

第15回 NEDIA アクションセミナー開催のご案内

NEDIA 企画委員会では、会員様向けに、タイムリー、かつ役立つ業界情報を提供し、会員様の価値向上を図るべく、アクションセミナーを企画し連続的に開催をしています。

第14回まで、自動車、パワーデバイス関係、半導体業界・製造装置業界の動向、半導体基礎、有機ELディスプレイ産業の動向について開催してきましたが、今回は、IoT時代の品質保証技術として注目されているバウンダリスキャン技術について、この分野において活躍されている講師を迎え、開催することになりました。ぜひ多くの会員様にご参加頂けることを心よりお待ちしております。

————— 開催案内 —————

1. 開催日時：2017年7月26日(水) 17:00～18:30
2. 開催場所：UTアドバンスト・キャリアセンター (UTACC) セミナールーム
東京都品川区東五反田 1-2-33 白雉ビル 4階 <http://www.ut-g.com/utacc/>
JR 山手線 五反田駅東口より徒歩5分 / 地下鉄浅草線 五反田駅 A6 番出口より徒歩3分

3. テーマ：「IoT時代の電子回路の品質保証技術

～電子デバイスのための最新バウンダリスキャン技術～

<講演概要>

今回は、あらゆるモノが電子回路を搭載し繋がる IoT時代において、電子回路の品質保証のために重要な役割を果たすバウンダリスキャン技術の最新動向を解説して頂きます。

バウンダリスキャンは電子デバイス業界では総合デバックインターフェース JTAG としてご存知の人が多いと思いますが、もともとこの技術は 1990 年に電子回路基板上のデバイスの相互接続テストのために制定された IEEE 標準規格です。

富士通においては当初から多くの製品の基板テストに使っており、例えばスーパーコンピュータ京では 8 億箇所のデバイスピンの接続保証に貢献しています。

またバウンダリスキャンは基板のテストだけでなく、LSI のテストにも使われます。

バウンダリスキャン最新技術によれば、多くの再利用可能 IP ブロックを組み込んだ LSI のテスト自動化 (IJTAG) とか模倣 IC 対策のための真贋判定への対応など進化しています。

更に 3D-LSI や部品内蔵基板デバイスの品質保証など適用領域が拡大しています。

ただ日本ではバウンダリスキャンを有効活用している企業がまだ少ないのが現実です。

4. 講師：亀山技術士事務所代表、愛媛大学大学院客員研究員 **亀山修一** 氏

<講師紹介>

1972 年に富士通に入社以来、45 年間にわたり電子回路の試験技術と試験設備の開発に従事し 2017 年 6 月定年退職。現在、亀山技術士事務所代表、愛媛大学大学院客員研究員。

IEEE-CS、電子情報通信学会、エレクトロニクス実装学会、日本技術士会等会員。

博士 (工学)、技術士 (電気電子)。

著書：バウンダリスキャンハンドブック (青山社)。

5. タイムテーブル：16：30～受付開始

17：00～18：00 セミナー

18：00～質疑応答（終了は18：30 予定）

6. 参加費：NEDIA 会員 1,000 円、非会員 3,000 円

ご参加の申込みは、7 月 20 日(木)までにメールにて事務局までお願い致します。

申込みを確認後、事務局より返信いたします。

定員(約 40 名程度)になりましたら、申込みの受け付けを終了させていただきます。

<事務局連絡先>

E-mail : info@nedia.or.jp TEL : 03-5823-4465 FAX : 03-5823-4475

以上